

Brüssel, 10. September 2026

Deutsche Industrie- und Handelskammer

Stellungnahme

Chips Act 2.0

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Chips Act 2.0.

A. Das Wichtigste in Kürze

In der deutschen gewerblichen Wirtschaft besteht breite Zustimmung, dass sich die Europäische Kommission weiterhin der Abhängigkeit der EU von der Halbleiterproduktion in einigen wenigen Ländern annimmt. Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen und protektionistischer Maßnahmen gewinnt die Verringerung dieser Abhängigkeiten für die Wirtschaft an Bedeutung, insbesondere zur Absicherung vor- und nachgelagerter Wertschöpfungsketten. Aus Sicht der Unternehmen ist dabei ein ganzheitlicher Ansatz, der das gesamte Elektronik-Ökosystem in den Blick nimmt, zentral.

Grundsätzlich sollte Autarkie weder das Ziel in einer global arbeitsteiligen Welt sein, noch ist sie realistisch zu erreichen. Dies gilt besonders für den hoch spezialisierten und globalisierten Halbleitersektor. Gleichwohl sollten die EU und ihre Mitgliedstaaten einseitige kritische Abhängigkeiten zügig verringern, auch um bei geopolitischen Krisen weiterhin kritische Industrien versorgen zu können. Neben einer stärkeren Diversifizierung durch Handel sind geeignete Rahmenbedingungen erforderlich, damit entlang der Halbleiterwertschöpfungskette europäische, global wettbewerbsfähige Unternehmen entstehen und ihre Produkte weltweit nachgefragt werden. Voraussetzung dafür sind eine kostengünstige Energieversorgung, der Rückbau von Bürokratie, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, eine gesicherte Fachkräftausbildung sowie eine moderne und vernetzte Infrastruktur in den Bereichen Digitalisierung, Energie und Verkehr. Insbesondere die Versorgung mit ausreichend Flächen, Rohstoffen und der Ausbau einer umfassenden digitalen Infrastruktur sind gemäß der Rückmeldungen aus der IHK-Organisation für den Halbleitersektor essenziell. Dabei sind, insbesondere vertiefende Kooperationen bestehender Forschungs- und Innovationsökosysteme sowie (grenzüberschreitender) Cluster von zentraler Bedeutung, denn die Umsetzung des Chips Act 2.0 erfolgt vor

allem in Clustern und Regionen, die Skaleneffekte und Technologietransfer stärker beschleunigen können.

Die im Chips Act 2.0 vorgeschlagenen Maßnahmen sind vor diesem Hintergrund differenziert zu bewerten. Aus Sicht der deutschen gewerblichen Unternehmen sind Vorhaben wie die Förderung von KMU, Start-ups und Scale-Ups im Chip-Bereich zu befürworten. Gleichzeitig sieht der Vorschlag weitreichende Eingriffe in unternehmerische Entscheidungen in Krisenzeiten vor, die aus Sicht der Wirtschaft kritisch zu bewerten sind.

B. Bewertung im Einzelnen

Innerhalb der deutschen gewerblichen Wirtschaft besteht breiter Konsens, dass Halbleiter von hoher Relevanz für die europäische Industrie sind. Vor diesem Hintergrund gibt es breite Zustimmung dafür, dass sich die Europäische Kommission der Abhängigkeit der EU von der Produktion von Halbleitern in einigen wenigen Ländern annimmt. Dabei sollte aber nicht nur die Halbleiter-Wertschöpfungskette, sondern das gesamte Mikroelektronik-Ökosystem berücksichtigt werden. Zudem machen einige Unternehmen vermehrt darauf aufmerksam, dass gerade mit Blick auf Leiterplatten und die PCB-Produktion kritische Abhängigkeiten entstehen.

Staatliche Eingriffe in Form von Subventionen oder durch Vorgaben für Unternehmensentscheidungen zur Priorisierung von Beschaffungen sind aus Unternehmenssicht differenziert zu bewerten, denn sie sind kein Allheilmittel und sollten ausschließlich in klar begründeten Ausnahmefällen, wie bei Marktversagen, zum Einsatz kommen. Eingriffe bei Schlüsseltechnologien werden innerhalb der Wirtschaft unterschiedlich kritisch gesehen. Einige Unternehmen sprechen sich für die Förderung zur Ansiedlung der Halbleiterproduktion aus – insbesondere vor dem Hintergrund der Resilienz und wirtschaftlicher (Versorgungs-)Sicherheit. Allerdings sind grundsätzlich öffentliche Ausgaben zur Verbesserung der allgemeinen Standortbedingungen gegenüber Subventionen vorzuziehen.

1. Bei Nachfragemassnahmen Industrie und KMU miteinbinden (Art. 7–Art. 11)

Nachdem der Chips Act 1 sich auf die Stärkung des Angebots fokussierte, sollen die Maßnahmen des Chips Act 2.0 nun die Nachfrage anreizen. Konkret sieht die Verordnung sog. „Große Herausforderungen“ (Art. 7) und sog. „Nachfragebeschleuniger“ (Art. 8) für Märkte wie Cloud, Automobil, Luftfahrt oder Verteidigung vor. Der Großteil der Wirtschaft fordert, dass bei der Umsetzung ein KMU-freundlicher Zugang zu den Nachfrageinitiativen zentral ist und unterschiedliche Akteure aus der Industrie sowie Innovations- und Technologieexperten beim Design der Maßnahmen beteiligt werden sollten. Unternehmen merken an, dass öffentliche Beschaffung ein Hebel sein kann, um Innovationen schneller in den Markt zu bringen. Die konkrete Ausgestaltung der genannten Maßnahmen lässt der Gesetzesvorschlag jedoch offen und verweist auf Stakeholdergremien, die diese ausarbeiten sollen. Letztlich sollten Entscheidungen nicht nur top-down, sondern auch bottom-up getragen werden, um Interessen frühzeitig abzustimmen und so die Programme praxisnah, transparent und wirkungsvoll umzusetzen.

Die Breite der Wirtschaft weist darauf hin, dass auch im Halbleiterbereich der Markt über den Erfolg von innovativen Produkten entscheidet und politisch anvisierte Produktionsvorgaben in bestimmten Segmenten oftmals mit Ineffizienzen einhergehen. Das Zusammenbringen von Industrien auf der Angebots- und der Nachfrageseite im Rahmen der Nachfragebeschleuniger und des Nachfrageforums (Art. 9) soll den Austausch und die Kooperation innerhalb der Wertschöpfungsketten ermöglichen. Eine Öffnung des Forums für Akteure aus der Wissenschaft könnte dazu beitragen, um auf diese Weise Investitionen im Bereich von Forschung und Innovation auf die Bedarfsentwicklung zuzuschneiden und anzupassen. Sowohl die hier genannten Maßnahmen als auch die innovationsfördernde Chip-Beschaffung (Art. 10) bedürfen jedoch weiterer Klarheit und Konkretisierung.

2. Stärkung von „Lab-to-Fab“-Ansatz richtig – gleichzeitig KMU-Zugang weiter gewährleisten (Art. 4–6)

Die Fortführung des „Lab-to-Fab“-Ansatzes durch die „Chips for Europe Initiative 2.0“ sollte darauf abzielen, exzellente Forschung in Europa und die industrielle Produktion enger miteinander zu verzahnen – insbesondere mit Blick auf fortgeschrittene Entwurfskapazitäten, Pilotanlagen, Quantenchips und Photonik. Zudem sollen flankierende Maßnahmen wie die Kompetenzzentren und ein erleichterter Zugang zu Finanzmitteln die Forschungs- und Innovationstätigkeiten innerhalb der Wertschöpfungskette unterstützen. Gleichzeitig sollte das langfristige Ziel jedoch sein, aus der exzellenten Innovation kommerzielle Erfolge zu erzielen („Lab-to-Market“).

Bei allen Aktivitäten der „Chips for Europe Initiative 2.0“ sollten die Einbeziehung Unternehmen aller Größe eine zentrale Rolle spielen. Neben der Unterstützung beim Zugang zu Finanzmitteln geht es um den Zugang zu Pilotanlagen. Hierfür ist insbesondere ein unkomplizierter und niederschwelliger Zugang für innovative Start-ups und KMU zu solchen Kooperationsprojekten wie den Pilotlinien und entsprechenden Infrastrukturen entscheidend – hierzu könnten beispielsweise Voucher-Modelle beitragen. Grundsätzlich sollten Berichts- und Dokumentationsanforderungen auf das absolut Notwendige beschränkt sowie proportional und ergebnisorientiert gestaltet sein. KMUs merken an, dass insbesondere die europäischen Förderprogramme deutlicher bürokratischer sind als vergleichbare Programme in anderen Regionen der Welt. Zudem braucht es KMU-gerechte Fertigungsplattformen. Zusätzlich fordert die Wirtschaft einen schnelleren Aufbau der Pilotanlagen. Vom Inkrafttreten des Chips Act 2023 bis zur Übergabe der deutschen Förderbescheide und den Aufbau der Pilotanlagen vergingen mehrere Jahre.

Beim Thema Fachkräfte ist wichtig zu beachten, dass Kompetenzmaßnahmen an den realen Arbeitsmarktbedürfnissen ausgerichtet sein sollten und nicht daran vorbeigehen. Gleichzeitig gilt es, keine Doppelstrukturen durch vorgeschlagene Kompetenzzentren aufzubauen, sondern regionale Kompetenzzentren in bestehende Bildungs- und Innovationsnetzwerke einzubetten. So kann die regionale Zusammenarbeit von Forschungseinrichtungen, Hochschulen, der Industrie und den IHKs zur Ausbildung von Halbleitertechnikern, Prozessingenieuren,

Packaging-Spezialisten einen wichtigen Beitrag zur Fachkräfteentwicklung leisten. Vor dem Hintergrund nationaler Initiativen wie der deutschen Hightech Agenda dürfen keine Doppelstrukturen ohne Mehrwert entstehen.

3. Europäische Halbleitertechnologieinitiativen: „First-of-a-Kind“ Ausweitung für Beihilfen – zielgerichtete Anwendung zentral (Art. 13–Art. 15, Erwägungsgründe 41-53)

Um umfangreiche Fördermittel im Rahmen des Chips Act zu erhalten, mussten Investitionen den Kriterien des sog. „First-of-a-Kind“-Ansatzes (FOAK, dt. neuartige Fähigkeiten) entsprechen. Nur unter diesen Voraussetzungen hat die Kommission entsprechende Beihilfen der Mitgliedstaaten genehmigt. Die vorgeschlagene FOAK-Ausweitung auf eine Reihe von Innovationselementen (z. B. Technologieknoten, Trägermaterial, Verbesserungen bei der Rechenleistung, der Energieeffizienz, dem Sicherheitsniveau, der Speicherkapazität, der Automatisierung von Packing oder mit Blick auf Umweltelemente) trägt dem Umstand Rechnung, dass das Halbleiterökosystem ganzheitlich betrachtet werden muss. Gleichzeitig sollte die Ausweitung nicht dazu führen, dass staatliche industriepolitisch motivierte Eingriffe in Form von Beihilfen beliebig zum Einsatz kommen.

Bei einseitigen kritischen Abhängigkeiten der EU von anderen Ländern können klar definierte und zielgerichtete staatliche Maßnahmen zur Reduzierung der Abhängigkeiten sinnvolle Ergänzungen sein. Dabei sollte die EU solche Initiativen auf europäischer Ebene koordinieren und nur in engem Austausch mit der Wirtschaft verfolgen. Allerdings sollten solche Eingriffe nur in wenigen und gut begründeten Ausnahmefällen und zeitlich begrenzt zum Einsatz kommen. Teile der Wirtschaft sehen entsprechende Eingriffe bei Schlüsseltechnologien weniger kritisch als andere. Zentral dabei ist, dass genehmigte Beihilfen nicht in Projekte fließen sollten, die an den europäischen Marktrealitäten vorbeigehen. Die größten Abnehmer auf Industrie-seite sind die Automobilhersteller, die jedoch nicht auf neuste Chip-Generationen angewiesen sind. Innerhalb der Wirtschaft wird daher die Unterstützung von Chip-Fabriken mit einer für den europäischen Markt angemessenen Strukturgröße prioritär angesehen. Einige Unternehmen weisen jedoch darauf hin, dass der Aufbau von Chip-Fabriken für die neuesten Generationen einen wichtigen Beitrag zur längerfristigen Versorgungssicherheit leisten, neue Industriezweige anlocken und zukünftige technologische Abhängigkeiten mindestens verringern sowie die Basis für neue, zukünftige Chip-Innovationen darstellen könnte. Zudem plädieren einige Unternehmen für die gezielte Förderung der gesamten Halbleiterwertschöpfungskette statt einer Konzentration auf Chipproduktion. Dass Europa nicht in allen Segmenten Weltmarktführer wird, steht außer Frage, aber insbesondere in den Bereichen wie Design, Spezialchips, Neuromorphic Computing, Leistungselektronik, Photonik und Packaging besitzt Europa wettbewerbliche Chancen.

4. Technologieoffenheit bei strategischen Projekten wahren (Art. 13, Art. 16–Art. 19, Erwägungsgründe 38-40 und 52-56)

Der Vorschlag sieht vor, dass Halbleiterprojekte als strategisch klassifiziert werden können, wenn diese sechs Anforderungskriterien erfüllen (z. B. Mehrwert für die Union, Durchführung

von inländischen Unternehmen, Beitrag zu Resilienz usw.; Art. 16). Anerkannte strategische Projekte fallen unter die vorgeschlagenen Beschleunigungsmaßnahmen und werden beim Erwerb weiterer Finanzmittel beraten (Art. 20). Darüber hinaus bieten strategische Projekte Unternehmen Stand heute nur einen begrenzten zusätzlichen Mehrwert. Zukünftig könnte eine Verknüpfung mit dem European Competitiveness Fund (ECF) eventuell europäische Gelder für solche Projekte bereitstellen. Insbesondere die Anwendung der Kriterien und das genaue Zusammenspiel von ECF und Chips Act 2.0 sind jedoch noch unklar und bedürfen Klärung.

Gleichzeitig sieht Annex II bereits vorrangige Bereiche für strategische Projekte vor¹. Fraglich ist, anhand welcher Kriterien diese Bereiche identifiziert wurden. Ähnlich wie bei den europäischen Halbleitertechnologieinitiativen sollten politische Akteure nicht allein entscheiden, welche Technologien als vorrangig gelten und welche nicht. Vor diesem Hintergrund sind auch die nachträglichen Änderungen am Annex II mithilfe delegierter Rechtsakte differenziert zu bewerten. Einerseits ist ein bestimmter Grad an Flexibilität angemessen, andererseits darf dies nicht zu Beliebigkeit führen. Dass die Kommission die Ausweitung in delegierte Rechtsakte verlagert, ist zu weitreichend und prozedural bedenklich, bei solch wichtigen Entscheidungen vom „regulären“ Gesetzgebungsverfahren abzuweichen und diese in nachgelagerte Rechtsakte zu verschieben.

5. Resilienz durch internationale Partnerschaften (Art. 2, Art. 14, Art. 16, Art. 47)

Sowohl bei den europäischen Halbleitertechnologieinitiativen als auch bei den strategischen Projekten sieht der Kommissionsvorschlag vor (Art. 14 Nr. 1 und Art. 16 Nr. 1 Buchst. b), dass ein Projekt von inländischen Unternehmen durchgeführt werden muss. Außerdem ist die Beteiligung bei strategischen Projekten auf Rechtsträger aus der Union beschränkt. Die deutsche gewerbliche Wirtschaft weist darauf hin, dass solche Bedingungen mit den WTO-Vorgaben kompatibel sein sollten und spricht sich daher für den Ansatz aus, Unternehmen aus Partnerstaaten in diesen Definitionen zu berücksichtigen (Art. 2). Sie unterstreicht die Bedeutung von internationalen Partnerschaften im Halbleitersektor und unterstützt die Initiativen des europäischen Halbleitergremiums zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit internationalen Partnern (Art. 47).

6. Beschleunigung von Genehmigungsverfahren von zentraler Bedeutung (Art. 21–Art. 25)

Die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die Beschränkung auf „Halbleitertechnologieinitiativen“ und „strategische Projekte“ greift jedoch zu kurz, da zunächst eine Anerkennung der Initiative bzw. des Projekts stattfinden muss, bevor eine Beschleunigung möglich wird. Unternehmen, die in den Halbleiterwertschöpfungsketten aktiv sind, aber nicht Teil der Initiativen oder strategischer Projekte, bleiben somit außen vor.

¹ 1) Europäische Fertigung fortgeschrittener Halbleiter, (2) KI-Chips und KI-Systeme für EU-Recheninfrastrukturen, (3) Fahrzeug-Anwendungsprozessoren für autonomes Fahren, (4) Europäische Speicherchipfertigungsanlage, (5) Entwurf modernster Chips, (6) Stärkung zentraler Segmente der Wertschöpfungskette

Die deutsche gewerbliche Wirtschaft spricht sich dafür aus, Beschleunigungsmaßnahmen unbürokratisch auf sämtliche Industrieprojekte auszuweiten.

Es ist ein guter Ansatz, dass der Chips Act 2.0 die Digitalisierung von Genehmigungsverfahren vorantreibt. Die Verknüpfung des Europäischen Business Wallets sollte benutzer- und insbesondere KMU-freundlich ausgestaltet werden. Der Chips Act 2.0 sollte vermeiden, neue digitale Insellösungen oder zusätzliche Portale ohne belastbare Prozessintegration zu schaffen und stattdessen standardisierte, offene Schnittstellen bereitstellen und vorhandene nationale Systeme anbinden. Für Unternehmen, insbesondere KMU, ist es wichtig, dass bestehende Daten, Nachweise und Zertifikate wiederverwendbar sind und nicht für jedes Verfahren neu erzeugt werden müssen.

7. Europäische Halbleiterexzellenzregionen (Art. 26–Art. 29)

Der Vorschlag, regionale Cluster zu identifizieren, ist sinnvoll. Neben der höheren Sichtbarkeit regionaler Stärken können Cluster zu einer besseren Vernetzung von Industrie, Forschung und Behörden beitragen. Gleichzeitig kann die internationale Zusammenarbeit zwischen den europäischen Clustern zu einem europaweiten Wissenstransfer von Best-Practices und Know-how führen und somit die Fachkräfteentwicklung und den Technologietransfer auch europaweit und international fördern. Fraglich ist, ob die im Vorschlag erwähnten Maßnahmen mit Blick auf Infrastruktur, Forschung und Entwicklung, Fachkräfte und Investitionsanreize in der Praxis umgesetzt werden können, da solche Maßnahmen maßgeblich von Entscheidungen auf nationaler und regionaler Ebenen abhängen. Auch hier betonen die Unternehmen, dass solche Maßnahmen richtig sind, grundsätzlich aber die Breite der Wirtschaft und nicht nur ausgewählte Sektoren erfassen sollten. Grundsätzlich gilt es, die regionalen Rahmenbedingungen möglichst attraktiv für Investitionen auszugestalten.

8. Monitoring und Kriseninstrumente dürfen nicht über das Ziel hinausschießen (Art. 32–43)

Mit Blick auf mögliche zukünftige Halbleiterkrisen legt die Verordnung einen Werkzeugkasten zum Umgang mit Lieferengpässen vor:

Risikoanfällige Sektoren (Art. 32). Die Kommission identifiziert risikoanfällige Sektoren in den Anhängen V und VI. Dazu gehören 13 kritische Sektoren und 10 Industriezweige (siehe Anhang der Stellungnahme), in denen Halbleiter verwendet werden. Die Kommission kann für diese Sektoren Leitlinien zu Risikobewertungen herausgeben und Risikominderungsmaßnahmen empfehlen. Sollten diese laut Kommission nicht angemessen umgesetzt werden, kann die Kommission einen Durchführungsrechtsakt über spezifische Risikominderungsmaßnahmen erlassen. Aus Sicht der deutschen gewerblichen Wirtschaft sollten solche Vorgaben eng begrenzt, verhältnismäßig und bürokratiearm sein. Eingriffe wie die Verpflichtung zum Aufbau von Lagerbeständen sind mit der unternehmerischen Freiheit nur schwer vereinbar. Auch die eigene Versorgung mit Halbleitern und die Diversifizierung liegen zuvorderst in der Eigenverantwortlichkeit von Unternehmen.

Strategische Kartierung des Halbleitersektors in der Union (Art. 33). Die Kommission führt zusammen mit dem Europäischen Halbleitergremium auf der Basis öffentlicher und gewerblich verfügbarer Daten eine strategische Kartierung des Halbleitersektors in der Union durch. Zudem kann sie freiwillige Auskunftersuchen an Akteure im Sektor richten. Die Unternehmen befürworten den freiwilligen Ansatz dieser Maßnahme und unterstreichen die Notwendigkeit eines vertraulichen Umgangs mit Blick auf die erlangten Informationen.

Unternehmensplattform für die Halbleiterlieferkette (Art. 34). Die Plattform soll als digitaler Zwilling der Lieferkette Transparenz, aggregierte Daten, Risikoanalysen, Stresstests, Frühwarnungen und Dashboard-Indikatoren ermöglichen. Es besteht Unklarheit, inwiefern die Plattform freiwillig ist, da sie zumindest Unternehmen, die entlang der Halbleiterlieferkette tätig sind, und Halbleiteranwender, insbesondere in den in Anhang VI genannten Sektoren, einbeziehen soll. Es können sich nur inländische Unternehmen beteiligen (Definition nach Art. 2). Eine verpflichtende Teilnahme an der Plattform wird von der Breite der Wirtschaft abgelehnt. Es besteht die Gefahr zusätzlicher Meldepflichten und weitreichender Einblicke in sensible Unternehmensdaten. Zudem stellt sich die Frage, wie hoch der Informationsgehalt der Plattform ist, wenn nur inländische Unternehmen berichten, einige zentrale Arbeitsschritte jedoch außerhalb der EU stattfinden.

Überwachung und Antizipation (Art. 35). Die Kommission kann im Rahmen der Überwachung der Halbleiterwertschöpfungskette wichtige Marktakteure auf freiwilliger Basis um Informationen bitten. Wichtige Marktakteure werden anhand von in der Verordnung festgelegten Kriterien ermittelt (Art. 36). Aus Sicht der Unternehmen sind solche Überwachungsinstrumente nur dann angemessen, wenn sie verhältnismäßig, risikobasiert und auf das notwendige Maß beschränkt bleiben.

Präventive Informationsbeschaffung (Art. 38). Im Falle einer Versorgungsunterbrechung mit Halbleitern kann die Kommission eine Sitzung der Plattform oder Auskunftersuchen an einzelne Unternehmen richten. Bei unrichtigen, unvollständigen oder irreführenden Informationen innerhalb der genannten Frist sind Sanktionen (Art. 51) möglich. Auch für die Informationsbeschaffung gilt, sie auf ein absolutes Minimum zu begrenzen, Geschäftsgeheimnisse zu schützen und Berichts- sowie Dokumentationspflichten proportional und ergebnisorientiert auszugestalten.

Notfallinstrumentarium im Falle von Engpässen (Art. 40–Art. 41). Wenn eine Krisenstufe aktiviert wird (Art. 39), kann die Kommission alle entlang der Halbleiterlieferkette tätigen Unternehmen auffordern, Informationen über ihr Produktionsvermögen, ihre Produktionskapazitäten und ihre derzeitigen Hauptstörungen bereitzustellen (Art. 41). Bei unrichtigen, unvollständigen oder irreführenden Informationen innerhalb der genannten Frist sind Sanktionen möglich. Sollten gleichzeitig Auskunftersuchen aus Drittstaaten bei einem Unternehmen eingehen, ist dies der Kommission zu melden. Dies kann jedoch zu sich widersprechenden rechtlichen Verpflichtungen der Unternehmen führen, die geschäftsschädigend für das Unternehmen sind, wenn es entscheiden muss, ob es ein vertrauliches Ersuchen eines anderen

Staates gegenüber der Kommission preisgeben muss. Insbesondere in Krisenzeiten sollte die Informationsbeschaffung auf ein Minimum beschränkt sein, zudem sollte auch gerade während Krisenzeiten ein Schutz von Geschäftsgeheimnissen gewährleistet werden. Dabei sollte auch immer die Verhältnismäßigkeit beachtet werden, andernfalls steht zu befürchten, dass europäische Unternehmen weniger vertrauenswürdig als Unternehmen aus Drittstaaten wahrgenommen werden könnten. Unternehmen weisen zudem darauf hin, dass unklar bleibt, wie eine „Krise“ definiert wird und wie „priority-rated orders“ (Art. 42) mit globalen Lieferketten und Kundenverträgen vereinbar sind.

Vorrangige Aufträge (Art. 42). Unternehmen, die im Rahmen des Chips Act 2.0 Unterstützung erhalten haben – sei es durch europäische Halbleiterinitiativen oder strategische Projekte – können von der Kommission zur Annahme von vorrangigen Aufträgen verpflichtet werden. Eine solche Verpflichtung geht jeder anderen Erfüllungsverpflichtung nach privatem oder öffentlichem Recht vor. Aus Sicht von Unternehmen sind solche Eingriffe kritisch zu bewerten, da derart weitreichende Eingriffe in die unternehmerische Freiheit das Risiko unbeabsichtigter negativer Auswirkungen bergen. Fraglich ist auch, wer in solchen Fällen haften würde, wenn Zulieferer in der Lieferkette für Schäden aus Produktionsstopps beim Kunden zahlen müssten. Staatliche Eingriffe an einzelnen Stellen dieser komplexen Wertschöpfungsketten können zu Konsequenzen an vielen anderen Stellen führen und letztlich auch Unterbrechungen in anderen wichtigen Wertschöpfungsketten sowie Gegenreaktionen anderer Länder hervorrufen. Dies könnte die Versorgung mit Halbleitern beeinträchtigen, da Wertschöpfungsketten in dieser extrem spezialisierten Branche global aufgestellt bleiben, auch wenn gewisse zusätzliche Produktionskapazitäten in der EU aufgebaut werden.

Gemeinsame Beschaffung (Art. 43). Nach der Aktivierung der Krisenstufe kann die Kommission auf Antrag von zwei oder mehr Mitgliedstaaten als zentrale Beschaffungsstelle im Namen aller zur Teilnahme bereiten Mitgliedstaaten bei der Vergabe ihrer öffentlichen Aufträge über krisenrelevante Produkte für kritische Sektoren tätig werden. Ein solches Vorgehen kann in Krisensituationen sinnvoll sein, da europäisch koordinierte Maßnahmen einzelstaatliche Konkurrenz vermeiden können. Gleichzeitig sollte eine gemeinsame Beschaffung marktkonform und transparent erfolgen. Zudem kann staatliche Beschaffung Auswirkungen auf die Preise krisenrelevanter Produkte haben und zu einer zusätzlichen Marktverzerrung in bereits angespannten Märkten führen. Grundsätzlich löst die gemeinsame Beschaffung aber nicht das Problem von Lieferengpässen: Im Falle von erkennbaren Lieferengpässen ist Beschaffung voraussichtlich nicht mehr möglich.

9. Wirtschaft in einfache Governance-Strukturen miteinbeziehen – Parallelstrukturen vermeiden

Der aktuelle Kommissionsvorschlag sieht eine Reihe an Gremien und Plattformen vor (Nachfrageforum (Art. 9), Netz der europäischen Halbleiterexzellenzregionen (Art. 29), Unternehmensplattform für die Halbleiterlieferkette (Art. 34), Europäisches Halbleitergremium (ESB, Art. 44-47), Netz der Kompetenzzentren, Industrieallianz für Halbleiter (Art. 49), Chips Joint

Undertaking). Die Notwendigkeit neuer und bestehender Institutionen sollte regelmäßig überprüft werden, um Überschneidungen und Parallelstrukturen zu vermeiden. Zudem sollten nicht nur bei den Zusammensetzungen der Gremien Wirtschaftsvertreter der gesamten Wertschöpfungskette miteinbezogen werden, sondern regelmäßige institutionalisierte und verbindliche Dialoge mit der Industrie in den strategischen Gremien stattfinden.

10. Finanzierung im Rahmen des nächsten MFR

Der Vorschlag zum Chips Act 2.0 sieht keine explizite Förderung vor. Die Finanzierung soll dabei vorrangig im Rahmen bestehender oder neuer Programme wie EIC/Horizon Europe, Digital Europe oder dem europäischen Wettbewerbsfähigkeitsfonds stattfinden. Bei den Verhandlungen zum nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) gilt es daher, die Investitionen in Wettbewerbsfähigkeit, Forschung und Innovation entsprechend zu priorisieren und adäquat auszustatten. Zudem sollten die Entscheidungsträger beim Chips-Fonds auf eine Anschlussfähigkeit bzw. klare Abgrenzung zu anderen Fördermöglichkeiten wie dem ScaleUpEurope-Fund hinwirken.

C. Ergänzende Informationen

a. Ansprechpartner mit Kontaktdaten

Thorben Petri

Referatsleiter Europäische Wirtschaftspolitik

petri.thorben@dihk.de

Dr. Susanne Gewinnus

Referatsleiterin Industrie- und Forschungspolitik

gewinnus.susanne@dihk.de

b. Beschreibung DIHK

Wer wir sind:

Unter dem Dach der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) sind die 79 Industrie- und Handelskammern (IHKs) zusammengeschlossen. Unser gemeinsames Ziel: Beste Bedingungen für erfolgreiches Wirtschaften.

Auf Bundes- und Europaebene setzt sich die DIHK für die Interessen der gesamten gewerblichen Wirtschaft gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit ein. Denn mehrere Millionen Unternehmen aus Handel, Industrie und Dienstleistung sind gesetzliche Mitglieder einer IHK - vom Kiosk-Besitzer bis zum Dax-Konzern. So sind DIHK und IHKs eine Plattform für die vielfältigen Belange der Unternehmen. Diese bündeln wir in einem verfassten Verfahren auf gesetzlicher Grundlage zum Gesamtinteresse der gewerblichen Wirtschaft und tragen so zum wirtschaftspolitischen Meinungsbildungsprozess bei.

Grundlage unserer Stellungnahmen sind die wirtschaftspolitischen Positionen und beschlossenen Positionspapiere der DIHK unter Berücksichtigung der der DIHK bis zur Abgabe der Stellungnahme zugegangenen Äußerungen der IHKs und ihrer Mitgliedsunternehmen.

Darüber hinaus koordiniert die DIHK das Netzwerk der 150 Auslandshandelskammern, Delegationen und Repräsentanzen der Deutschen Wirtschaft in 93 Ländern.

Die DIHK ist im Transparenzregister der Europäischen Union unter der Nummer 22400601191-42 registriert.

Anhang:

Kritische Sektoren (Anhang V Chips Act 2.0):

1. Energie
2. Verkehr
3. Banken
4. Finanzmarktinfrasturktur
5. Gesundheit
6. Trinkwasser
7. Abwasser
8. Digitale Infrastruktur
9. Öffentliche Verwaltung
10. Weltraum
11. Produktion, Verarbeitung und Vertrieb von Lebensmitteln
12. Verteidigung
13. Sicherheit

Industriezweige, in denen Halbleiter verwendet werden (Anhang VI Chips Act 2.0)

1. Automobilindustrie
2. Rechenzentren, Cloud und KI
3. Industrielle Automatisierung und Robotik
4. Luftfahrt
5. Weltraum, Verteidigung und Sicherheit
6. Infrastrukturen für die elektronische Kommunikation
7. Rechner in anspruchsvollen Industrieumgebungen und Internet der Dinge
8. Gesundheitswesen und medizinische Geräte
9. Anbieter von Fertigungsdienstleistungen im Elektronikbereich und Händler
10. Systeme für erneuerbare und CO₂-arme Energie